有研半导体硅材料股份公司

2025 第三季度报告

证券代码:688432　　证券简称:有研硅

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	255,651,388.54	−3.87	746,566,316.75	−3.43
利润总额	70,083,342.73	−17.53	220,348,705.95	−13.00
归属于上市公司股东的净利润	50,083,284.45	−21.99	156,118,030.81	−19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,618,503.45	−51.41	99,183,884.66	−31.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	201,042,551.91	40.16
基本每股收益(元/股)	0.0403	−21.99	0.1255	−19.74
稀释每股收益(元/股)	0.0402	−22.02	0.1254	−19.78
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少0.35个百分点	3.56	减少1.06个百分点
研发投入合计	25,471,723.88	62.01	69,687,038.63	18.52
研发投入占营业收入的比例(%)	9.96	增加4.05个百分点	9.33	增加1.73个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,384,637,463.66	5,367,768,357.56	0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,444,573,138.85	4,341,587,040.23	2.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,850,934.60	2,928,545.32	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,931,585.43	47,281,928.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,318,863.03	25,603,663.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700,484.53	533,474.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,042,602.18	11,332,848.70	
少数股东权益影响额(税后)	3,294,484.41	8,080,616.38	
合计	24,464,781.00	56,934,146.15	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−51.41	主要为本期对权益法核算参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司增资,持股比例上升,且该公司亏损增加以及计提股份支付等原因,导致公司利润减少,同时本期政府补助增加,导致扣除非经常性损益后净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−31.16	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	40.16	主要为本期销售商品收到的现金增加且购买商品支付的现金减少所致。
研发投入合计_本报告期	62.01	本报告期加大研发投入力度导致研发费用增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			22,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.84	384,750,000	384,750,000	无 / 0
株式会社RS Technologies	境外法人	327,090,400	26.22	327,090,400	327,090,400	无 / 0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.47	0	0	无 / 0
福建仓元投资有限公司	境内非国有法人	28,215,000	2.26	28,215,000	28,215,000	无 / 0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	14,319,986	1.15	0	0	无 / 0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	8,875,117	0.71	0	0	无 / 0
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,773,689	0.70	0	0	无 / 0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	8,559,953	0.69	0	0	无 / 0
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,472,540	0.68	0	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	其他	7,327,921	0.59	0	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国有研科技集团有限公司	230,422,500		人民币普通股	230,422,500		
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	14,319,986		人民币普通股	14,319,986		
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	8,875,117		人民币普通股	8,875,117		
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)	8,773,689		人民币普通股	8,773,689		
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	8,559,953		人民币普通股	8,559,953		
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,472,540		人民币普通股	8,472,540		
香港中央结算有限公司	7,327,921		人民币普通股	7,327,921		
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,917,555		人民币普通股	3,917,555		
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,420,201		人民币普通股	3,420,201		
长江证券股份有限公司—华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	2,836,402		人民币普通股	2,836,402		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2、株式会社RS Technologies与福建仓元投资有限公司已签署一致行动协议。 3、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

注:有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示,截至2025年9月30日,"有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户"持股数为3,555,336股,占公司总股本的比例为0.28%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司分别于2025年3月14日、2025年3月31日,召开第二届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东会审议通过《关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》,拟以日元119,138.82万元(折合人民币5,846.97万元)的对价购买公司的控股股东株式会社RS Technologies持有株式会社DG Technologies70%的股份。截至本报告披露日,公司已完成北京市商务局、北京市发展和改革委员会对上述收购事项的审批备案,现正根据日本《外汇及贸易法》,加快推进日本外商直接投资相关审批程序。本次交易能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	876,667,613.06	1,029,893,380.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,650,571,178.08	1,910,071,561.64
衍生金融资产		
应收票据	58,657,282.80	74,479,689.41
应收账款	280,676,689.29	209,112,419.43
应收款项融资	120,231,214.23	129,563,009.25
预付款项	4,713,276.20	16,130,945.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	615,281.37	487,015.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,737,729.63	209,424,045.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,241,883.13	9,040,232.63
流动资产合计	3,235,112,147.79	3,588,202,298.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	692,551,306.68	350,511,948.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,058,028,154.47	1,027,313,509.72
在建工程	249,393,919.66	246,835,396.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,677,343.09	6,853,455.68
无形资产	79,653,468.22	80,750,147.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,565,059.73	5,624,403.02
递延所得税资产	6,492,332.16	5,625,377.31
其他非流动资产	21,163,731.86	26,051,820.49
非流动资产合计	2,149,525,315.87	1,779,566,059.30
资产总计	5,384,637,463.66	5,367,768,357.56
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,246,383.35	115,721,960.05
应付账款	134,564,196.21	114,984,070.90
预收款项		
合同负债	534,283.59	674,946.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,256,464.25	37,039,556.40
应交税费	17,148,018.75	17,493,380.99
其他应付款	85,662,687.80	87,248,694.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,162,342.51	4,858,613.87
其他流动负债		
流动负债合计	305,574,376.46	378,021,222.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,760,700.00	2,118,850.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,494,436.54	190,683,646.81
递延所得税负债	38,104.29	
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,293,240.83	192,802,497.27
负债合计	457,867,617.29	570,823,719.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,277,576,556.85	2,257,339,498.13
减:库存股	35,935,687.59	35,935,687.59
其他综合收益		
专项储备	9,859,587.31	8,584,634.90
盈余公积	35,332,565.28	35,332,565.28
一般风险准备		
未分配利润	910,119,059.00	828,644,971.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,444,573,138.85	4,341,587,040.23
少数股东权益	482,196,707.52	455,357,597.51
所有者权益(或股东权益)合计	4,926,769,846.37	4,796,944,637.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,384,637,463.66	5,367,768,357.56

公司负责人:张果虎　主管会计工作负责人:杨波　会计机构负责人:李文彬

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	746,566,316.75	773,102,420.66
其中:营业收入	746,566,316.75	773,102,420.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,368,676.12	575,839,139.06
其中:营业成本	459,029,332.07	490,354,379.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,083,018.18	5,010,496.35
销售费用	12,058,087.17	10,614,388.53
管理费用	33,208,445.99	24,816,124.56
研发费用	69,687,038.63	58,800,004.10
财务费用	−6,697,245.92	−13,756,254.44
其中:利息费用	153,433.44	273,539.69
利息收入	−7,596,287.07	−16,985,632.74
加:其他收益	61,390,120.06	46,446,796.96
投资收益(损失以"−"号填列)	−8,689,501.94	−4,157,436.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−35,684,510.34	−21,020,219.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	1,451,855.39	13,225,876.71
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−967,864.04	−1,164,660.37
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−1,652,363.55	1,554,487.89
资产处置收益(损失以"−"号填列)	77,610.72	55,165.92
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	219,807,497.27	253,223,512.66
加:营业外收入	760,407.47	79,842.22
减:营业外支出	219,198.79	41,059.33
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	220,348,705.95	253,262,295.55
减:所得税费用	36,471,169.93	30,784,689.17
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	183,877,536.02	222,477,606.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	183,877,536.02	222,477,606.38
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	156,118,030.81	194,681,391.43
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	27,759,505.21	27,796,214.95
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	183,877,536.02	222,477,606.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,118,030.81	194,681,391.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,759,505.21	27,796,214.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1255	0.1564
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1254	0.1564

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张果虎　主管会计工作负责人:杨波　会计机构负责人:李文彬

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,897,656.32	514,743,901.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,349,288.59	12,983,439.89
收到其他与经营活动有关的现金	30,545,697.09	46,102,091.69
经营活动现金流入小计	597,792,642.00	573,829,433.01
购买商品、接受劳务支付的现金	195,624,440.04	265,352,007.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	125,769,486.98	113,729,344.93
支付的各项税费	53,347,529.44	33,326,402.02
支付其他与经营活动有关的现金	22,008,633.63	17,980,982.20
经营活动现金流出小计	396,750,090.09	430,388,736.69
经营活动产生的现金流量净额	201,042,551.91	143,440,696.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,845,400,000.00	5,250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,104,047.26	26,349,112.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	3,333.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,846,985.52	534,200.02
投资活动现金流入小计	5,885,456,032.78	5,276,886,646.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,776,841.60	156,939,978.01
投资支付的现金	5,960,000,000.00	5,740,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,802,180.24	5,026,222.36
投资活动现金流出小计	6,078,579,021.84	5,901,966,200.37
投资活动产生的现金流量净额	−193,122,989.06	−625,079,554.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	1,181,388.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	1,181,388.80
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,800,000.00	1,181,388.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,725,739.32	27,416,242.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,081,796.00	14,975,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,135,815.27	39,462,976.38
筹资活动现金流出小计	88,861,554.59	66,879,218.97
筹资活动产生的现金流量净额	−79,061,554.59	−65,697,830.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,303.54	−2,185,951.03
五、现金及现金等价物净增加额	−71,138,688.20	−549,522,639.20
加:期初现金及现金等价物余额	905,848,935.90	1,477,120,831.11
六、期末现金及现金等价物余额	834,710,247.70	927,598,191.91

公司负责人:张果虎　主管会计工作负责人:杨波　会计机构负责人:李文彬

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688432　　证券简称:有研硅　　公告编号:2025-037

有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将具体调整事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的审批程序

1.2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司2024股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024年9月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-042)。

4.2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5.2024年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-043)。

6.2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-047)及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(截止授予日)》。

7.2024年10月24日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》(公告编号:2024-048),公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8.2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9.公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10.2025年4月23日,公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》,股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日,股票期权预留授予登记数量为90.00万份,股票期权预留授予登记人数为34人。

11.2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,根据2024年第二次临时股东大会的授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时,第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值,公司层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权,公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权,本次实际可行权激励对象为92名,行权数量为268.08万份,行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、本次股票期权激励计划行权价格的调整说明

(一)调整原因

2025年4月25日,公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,同意向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,247,621,058股,扣除回购股份3,555,336股,以此计算本次拟派发现金红利74,643,943.32元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,若公司发生派发股票红利的情况,股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

(二)调整情况

根据公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有派发股票红利的情况,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下:

$P=P0-V$

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。根据以上公式,本次调整后的行权价格=9.11−0.06=9.05元/股。公司董事会根据2024年第二次临时股东大会授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整,经过本次调整后,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司股票期权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬和考核委员会意见

公司董事会薪酬和考核委员会认为:本次调整符合《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权;公司本次股票期权激励计划调整行权价格、本次行权条件的成就及本次注销符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续,并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688432　　证券简称:有研硅　　公告编号:2025-034

有研半导体硅材料股份公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2025年10月20日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》

公司拟将"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"中一部分资金11,922万元用于新建"集成电路用8英寸硅片再扩产项目",原"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月;新建项目预计完成时间为2026年12月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提请公司股东会审议批准。

(二)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》

为更好地发挥股权激励作用,确保公司长期发展目标的实现,公司结合相关法律法规的规定和实际授予情况,进一步明确2024年股票期权激励计划预留部分公司业绩考核要求和个人层面绩效考核要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

(三)审议通过《关于调整